

БАЖК. 467761.006СБ

Перв. примен.

БАЖК.467761.006

Справ. №

1. * Размеры для справок.

2. Общие технические требования к установке компонентов поверхностного монтажа: ^{DA2} ~~DA1~~, DA3, DD1, DD2, C1, C3-C14, VD1-VD7, ^{R4-R10} ~~R11~~, ~~R13~~, R15-R18, R20-R34 по БЖАК.680242.001 ОТТ

3. Общие требования к установке элементов по ОСТ В95 2531-87.

Элементы установить по ОСТ В95 2537-87:

R12 - по варианту II-08 /Луст.= 20 мм/,

R14 - по варианту II-08 /Луст.= 16,25 мм /.

4. Технические требования к электромонтажу по ОСТ В95 1751-85

Элемент ВQ1 распаять проводом поз. 65 .

5. Цепь "В" выведена на контакт 1 разъема ХР1, отверстие 2; цепь "9V" - на контакт 3 разъема ХР1.

6. Припой ПОС61 ГОСТ 21930-76.

7. Клей ВК-9 ОСТ В95 1653-75.

8. Микросхема DD2 должна быть запрограммирована на этапе настройки печатного узла в соответствии с таблицей 1.

Программирование и проверку микросхемы DD2 проводить в соответствии с БАЖК.467761.006 И16.

БАЖК.467761.006СБ

Модулятор
Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

2:1

Лист 1

Листов 4

Подп. и дата

32392/1-10 17.03.10

Инв. № подл.

Взам. Инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подп. и дата

9. Покрытие лак УР-23 ^{ТУ6-21-14-90} в три слоя. *Допускается покрытие, лак Humised 1® 1A68, два слоя.* (5)
 От покрытия предохранить элементы XP1, XP2; резистор R19; отверстия 1 – 10, DK, ~~KT1~~, KT2. (4)

Допускается попадание лака на корпус элемента R19, кроме поверхности со стороны регулировочного винта.

Допускается отсутствие лака в местах установки элементов XP1, XP2. При покрытии лаком из пульверизатора все контакты элементов XP1, XP2, отверстия 1 – 10, DK, ~~KT1~~, KT2 соединить электрически между собой и заземлить. (4)

10. Маркировать заводской номер печатного узла, условное обозначение и номер изменения программного обеспечения микросхемы DD2 шрифтом 2,5-Пр3 ГОСТ26.020-80 эмалью ЭП-572 черной.

Маркировку микросхемы DD2 выполнять на бумаге поз.66 согласно таблице 1. Бумагу клеить к поверхности А микросхемы DD2 клеем 88-НП ТУ38-105.540-85 в месте, свободном от маркировки завода-изготовителя микросхемы.

Допускается маркировка микросхемы DD2 любым способом непосредственно на корпусе микросхемы в месте, свободном от маркировки завода-изготовителя.

Допускается маркировка четким произвольным шрифтом эмалью контрастного цвета.

Маркировка элементов и их выводов показана условно.

11. Позиции 5-10, 12-14, 17-24, 26-28, 30-41, 45-48, 50, 52, 53, 55-58, 61,66 не вынесены.

12. Остальные технические требования по ОСТ В95 2606-90.

① 13. Плату настроить и проверить по инструкции БАЖК.467761.006И16.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
32392/1	12.12.2010			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в документе	№ док.	Входящий № сопров. документа и дата	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулиро- ванных					
1	2	—	—	—	4	БАНК. 290-10	13.5.10		
2	1	—	—	—	4	БАНК. 892 ² / ₃ -10	19.10.10		
3	1	—	—	—	4	БАНК. 1150 ² / ₃ -10	12.1.11		
4	1, 2, 3	—	—	—	4	БАНК. 1130 ² / ₂ -10	31.1.11		
5	2	—	—	—	4	БАНК. 136-11	9.3.11		
6	3	—	—	—	4	БАНК. 401-11	11.5.11		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
32392/5	15.05.17.03.10			

БАЖК.467761.006СБ

ЛІСТ

4